

证券代码：002185

证券简称：华天科技

天水华天科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	开源证券股份有限公司 朱秀明 博时基金管理有限公司 何坤 公司接待人员：副总经理及董事会秘书常文瑛、证券部部长许腾旭、证券事务代表杨彩萍
时间	2024年8月28日上午
地点	公司子公司华天科技（西安）有限公司
形式	现场交流
交流内容及具体问答记录	<p>交流内容主要如下：</p> <p>1、公司目前主要生产基地及经营情况</p> <p>公司的主要生产基地有天水、西安、昆山、南京、韶关、Unisem以及刚投产的江苏和上海。天水基地以引线框架类产品为主，产品主要涉及驱动电路、电源管理、蓝牙、MCU、NOR Flash 等。西安基地以基板类和 QFN、DFN 产品为主，产品主要涉及射频、MEMS、指纹产品、汽车电子、MCU、电源管理等。南京基地以存储器、射频、MEMS 等集成电路产品的封装测试为主。昆山基地封装晶圆级产品，主要产品包括 TSV、Bumping、WLCSP、Fan-Out 等。韶关基地以引线框架类封装产品、显示器件和显示模组产品为主。Unisem 封装产品包括引线框架类、基板类以及晶圆级产品，主要以射频类产品为主。华天科技（江苏）有限公司、上海华天集成电路有限公司今年刚投产，华天江苏封装的产品有 Bumping、WLCSP、Fan-Out 等晶圆级产品，华天上海主要开展晶圆测试和成品测试业务。</p> <p>2024 年上半年，公司经营业绩同比大幅提高，公司实现营业收入 67.18 亿元，同比增长 32.02%，归母净利润 2.23 亿元，</p>

同比增长 254.23%，其中二季度归母净利润 1.66 亿元，环比一季度增长 190.53%。

2、未来行业发展趋势及下半年展望

全球半导体行业具有一定的周期性，景气周期与宏观经济和下游应用需求以及自身产能库存等因素密切相关。近年来，在政策支持、市场需求及资本推动等因素合力下，我国半导体产业规模快速增长，占全球市场的比重持续提高。消费电子、高速发展的计算机和网络通信等市场应用已成为我国集成电路的主要应用领域，随着智能手机、平板电脑等消费电子的升级换代，以及传统产业的转型升级，汽车电子、安防、人工智能等应用场景的持续拓展，将持续拉动对集成电路的旺盛需求。在我国集成电路产业链中，封装测试产业已经成为我国集成电路产业链中最具国际竞争力的环节，有望率先实现全面国产替代。

2024 年以来，全球半导体市场呈现出回暖态势。根据美国半导体行业协会数据，全球和中国半导体市场销售额自 2023 年 11 月连续 8 个月均实现同比正增长，且 2024 年以来一直保持两位数增幅。目前，多家行业分析机构预测全年半导体行业销售额实现正增长，其中美国半导体行业协会预计 2024 年全球半导体行业销售额将增长至 6,112 亿美元，2025 年有望达到 6,874 亿美元。

3、公司研发投入以及重点的研发布局

公司重视集成电路封装技术和产品创新工作，不断加大研发投入，确定以先进封装测试为研发发展方向，近年来公司研发投入占营业收入的比例保持在 5%以上。2024 年上半年公司研发投入 4.23 亿元，占营业收入比例为 6.29%，目前公司重点研发内容包括 Fan-Out、FOPLP、汽车电子、存储器等先进封装技术和封装产品。

	<p>4、如何看待公司毛利率提升</p> <p>由于 2022-2023 年上半年半导体市场下行、终端电子产品需求减弱等不利因素的影响，2022 年和 2023 年公司毛利率持续下行。2023 年下半年，尤其是进入 2024 年以来，行业出现回暖迹象，公司经营情况不断向好，毛利率有所修复和改善，2024 年 Q1 毛利率同比大幅提升，2024 年 Q2 毛利率进一步提升。</p> <p>5、公司在并购方面的考虑</p> <p>公司于 2019 年 1 月完成以要约方式收购 Unisem 股份事项，并将 Unisem 纳入合并范围，目前公司持有 Unisem 42.75%股份。后续，公司仍将积极寻找符合公司发展战略的并购项目，通过资源整合，不断提升公司封装技术水平，优化客户结构，提高市场份额，促进公司稳健发展。</p> <p>6、未来资本开支情况</p> <p>2024 年上半年公司固定资产支出 20 多亿元，主要是先进封装相关的投入，大概占比 70-80%，剩下的投入为公司根据客户需求和一些产能填平补齐所进行的投资。预计全年资本开支 35 亿左右，最终投资金额可能会根据市场情况和客户需求出现一定调整。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露的重大信息</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>